

株式会社 御中

PCN1207-1e
平成24年10月9日
富士通セミコンダクター株式会社
品質保証統括部
信頼性管理部
プロジェクト課長 吉本 正則



ボンディング・ワイヤ材の変更について（通知・依頼）

拝啓、貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、格別のご高配に賜り誠にありがとうございます。
さて表記の件、ボンディング・ワイヤ材の変更を計画しております。
つきましては、下記に変更内容をご報告いたしますので、内容ご賢察の上、ご承認のほど、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

- 記 -

1. 変更内容

- ・ボンディング・ワイヤ材を **金線 (Au Wire)** から **銅線 (Cu Wire)** へ変更。

2. 変更理由

- ・将来にわたる製品の安定供給を目的にボンディング・ワイヤ材を変更いたします。

3. 変更に伴う変化点

- ・4M 変化点の内、材料(Au Wire Cu Wire 等)と設備(現行ワイヤ付け装置に酸化防止ユニットを追加)の2点の変更となります。また南通 FM3 品種は半田メッキを E2(Pure-Sn)に統一させていただきます。

4. 対象製品および切換えスケジュール

- ・対象製品及び製品毎の切換えスケジュールは、品種リストをご参照願います。
ジェイデバイス譲渡に伴う工場移管が伴うため、FIM 九州品の銅ワイヤ化は当面延期させていただきます。

5. その他

- ・Cu Wire 化による製品の電気特性および品質・信頼性につきましては現行製品と同等であることを確認しております。
また、弊社では2010年度よりCu Wire を適用した製品を生産・出荷しており、十二分な市場実績も有ります。

6. 添付資料

- ・対象品種リスト
- ・詳細ご説明資料・・・一式

貴社ご確認欄 (問題：有り・無し)

- 以 上 -